
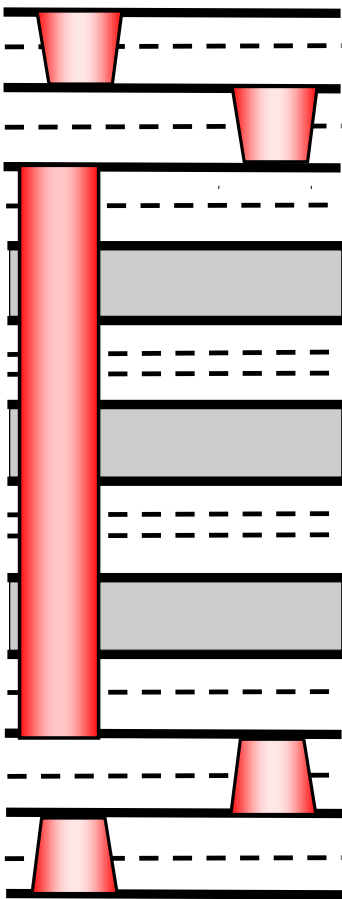


LAGENAUFBAU HDI (Standard)														
HDI12_2+8b+2_1,25_17.5			12 - Lagen							Kerne: 0,10 mm Cu 17.5/17.5 µm				
WE-Artikel Nr.:		2 + 8B + 2												
KUNDE:														
LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU			BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG					
KUNDE	WE							[µm]	[µm]					
1	TOP/VS				Folie	12 µm	1)	12						
									1 x 1080	60				
2	VSK2				Folie	12 µm		30						
									1 x 1080	60				
3	VSK1				Folie	12 µm		38						
									1 x 1080	66				
4	2					17.5 µm		16						
					0,10 mm			100						
5	3					17.5 µm		16						
									2 x 1080	134				
6	4					17.5 µm		33						
		0,10 mm			100									
7	5		17.5 µm		33									
						2 x 1080	134							
8	6		17.5 µm		33									
		0,10 mm			100									
9	7		17.5 µm		33									
						1 x 1080	66							
10	RSK1		12 µm		38									
						1 x 1080	60							
11	RSK2	Folie	12 µm		30									
						1 x 1080	60							
12	BOT/RS	Folie	12 µm	1)	12									
					1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm									
					Gesamtdicke Material: 1264									
					Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)									
MATERIALDICKE:		1,25	+/-	0,11	mm	Datum:		Bearbeiter:						
DICKE über galv. Endoberfläche		1,34	+/-	0,14	mm									
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer		1,40	+/-	0,16	mm									
Kundenforderung:			+/-		mm	Messstelle:								
Erstellt am		von		Geprüft am		von		Freigegeben am						
29.03.2006		S.Keller		04.05.2006		M.Kress		04.05.2006						
								Revision						
								00						
								Seite: 18+						